

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 4 月 21 日 (21.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/035223 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B29C 47/92, 5670052 大阪府茨木市室山 2 丁目 1 3 番 1 号 日本合成化学工業株式会社 中央研究所内 Osaka (JP).
47/36, 49/04 // B29K 29:00, B29L 9:00
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015071 (74) 代理人: 朝日奈 宗太, 外(ASAHINA, Sohta et al.); 〒5400012 大阪府大阪市中央区谷町二丁目 2 番 2 2 号 NS ビル Osaka (JP).
- (22) 国際出願日: 2004 年 10 月 13 日 (13.10.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-353790
2003 年 10 月 14 日 (14.10.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本合成化学工業株式会社 (THE NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5316029 大阪府大阪市北区大淀中一丁目 1 番 8 8 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 宮住 伸太 (MIYAZUMI, Shinta) [JP/JP]; 〒7128052 岡山県倉敷市松江 4 丁目 8 番 1 号 日本合成化学工業株式会社 水島事業所内 Okayama (JP). 江本 芳雄 (EMOTO, Yoshio) [JP/JP]; 〒7128052 岡山県倉敷市松江 4 丁目 8 番 1 号 日本合成化学工業株式会社 水島事業所内 Okayama (JP). 井上 馨 (INOUE, Kaoru) [JP/JP]; 〒
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING MULTILAYER STRUCTURE

WO 2005/035223 A1
(54) 発明の名称: 多層構造体の製造方法

(57) Abstract: A process for multilayer structure production in which it quickly becomes possible, after restarting, to obtain a satisfactory molded object without the need of using a special purging material. In the process, which comprises feeding a saponified ethylene/vinyl acetate copolymer and other resins(s) to a melting/molding machine having a die to mold a multilayer structure, the saponified ethylene/vinyl acetate copolymer residing in the melting/molding machine is allowed to stand at a temperature lower by 0 to 100°C than the melting/molding temperature throughout the period from a melting/molding operation conducted for a certain time to the restarting of a melting/molding operation.

(57) 要約: 特殊なパージ剤を用いることなく、再立ち上げ後早急に良好な成形物を得ることができる多層構造体の製造方法を提供すること。エチレン-酢酸ビニル共重合体ケン化物および他の樹脂をダイスを有する溶融成形機に供給して多層構造体を成形加工するにあたり、一定時間溶融成形加工を行った後に再度溶融成形加工を開始するまでの間、溶融成形機内に滞留しているエチレン-酢酸ビニル共重合体ケン化物を溶融成形時の加工温度より 0 ~ 100°C 低い温度で放置しておく。